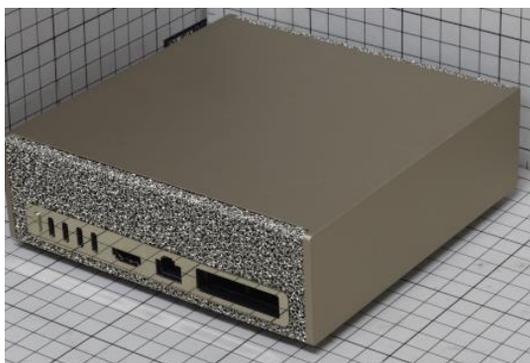
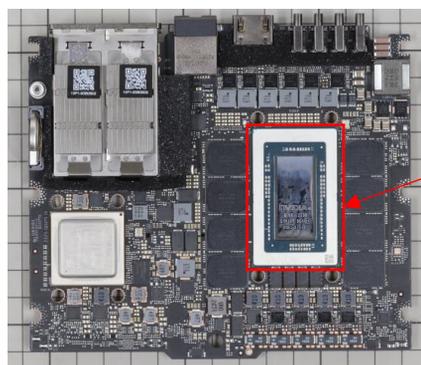


AI Computer : NVIDIA DGX Spark_(GB10 Grace Blackwell) ティアダウンレポート



NVIDIA DGX Spark™製品外観



搭載基板

GB10

レポート概要

NVIDIA DGX Spark™は、GB10 Grace Blackwell Superchipを搭載した世界最小クラスのAIスーパーコンピューターで、卓上サイズながら最大1ペタFLOPSの性能を発揮し、2000億パラメータ規模の生成AIモデルをローカルで扱える高効率システムです。GB10 Grace Blackwell Superchipは、NVIDIAが2025年に発表した最新AI向けSoCで、CPUとGPUを統合したペタFLOPS級の処理性能を持つ革新的チップです。GB10はGrace CPUとBlackwell GPUを2.5D技術で統合し、128GB統合メモリ搭載の高効率小型パッケージです。本レポートはNVIDIA DGX Sparkのティアダウンレポートです。

製品特徴

ユニットサイズ : (W)150mm x (L)150mm x (H)50.5mm
 ユニット重量 : 1200g
 搭載基板 : 1枚 (W)140mm x (L)122mm x (H)1.6mm

レポート内容・価格

ティアダウンレポート（分解工程+主要部品調査）：¥ 680,000(税別)

- ・ユニットの分解
- ・搭載部品調査（主要部品調査+搭載部品数）

(※M/B・GB10パッケージ・チップの解析も進行中です(25R-0698-2,3,4,5)。)

	Page
<u>Summary</u>	
Table 1 製品概要	... 3
<u>Overview</u>	
Fig. 1 製品外観	... 4
Fig. 2 製品ラベル	... 5
Fig. 3-1 製品分解1	... 6
Fig. 3-2 製品分解2	... 7
Fig. 3-3 製品分解3	... 8
Fig. 3-4 製品分解4	... 9
Fig. 3-5 製品分解5	... 10
Fig. 3-6 製品分解6	... 11
Fig. 4 基板外観	... 12
Fig. 5 基板防湿材塗布領域	... 13
Fig. 6-1 搭載部品位置 (Top View)	... 14
Fig. 6-2 搭載部品位置 (Bottom View)	... 15
<u>PartsList</u>	
Table 2-1 基板主要部品 (1)	... 16
Table 2-2 基板主要部品 (2)	... 17
Table 2-3 基板主要部品 (3)	... 18
Table 2-4 基板主要部品 (4)	... 19